

中華民國專利證書

新型第 M597696 號

新型名稱：改善銲接溶液量的引流裝置

專利權人：台林電通股份有限公司

新型創作人：林松釜、張正揚、李嘉怡、謝榮綸、陳正昇

專利權期間：自2020年7月1日至2030年2月11日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



109 年 7 月 1 日



【11】 證書號數：M597696**【45】 公告日：**中華民國 109 (2020) 年 07 月 01 日**【51】 Int. Cl.：** *B23K20/26 (2006.01)*

新型

全 3 頁

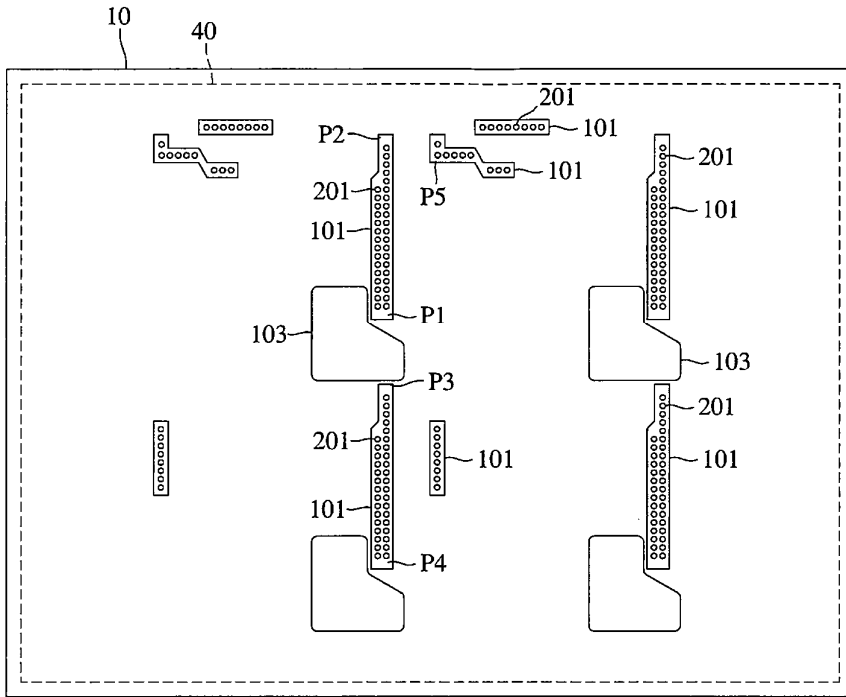
【54】 名 稱： 改善銲接溶液量的引流裝置**【21】 申請案號：** 109201523 **【22】 申請日：** 中華民國 109 (2020) 年 02 月 12 日**【72】 新型創作人：** 林松釜 (TW) LIN, SUNG-FU；張正揚 (TW) CHANG, CHENG-YANG；李嘉怡 (TW) LEE, CHIA-YI；謝榮綸 (TW) HSIEH, JUNG-LUN；陳正昇 (TW) CHEN, CHENG-SHENG**【71】 申請人：** 台林電通股份有限公司 TAILYN TECHNOLOGIES, INC.
桃園市蘆竹區榮安路 10 號**【74】 代理人：** 侯德銘；林彥丞**(NOTE)備註：** 相同的創作已於同日申請發明專利(Another patent application for invention in respect of the same creation has been filed on the same date)**【57】 申請專利範圍**

1. 一種改善銲接溶液量的引流裝置，包括：一本體，該本體包括至少一穿孔及至少一引流槽，且該至少一穿孔連接至該至少一引流槽；其中，該本體設置於一待銲物上，該至少一穿孔對準該待銲物上的至少一待銲接處，該至少一引流槽引導並容置用於銲接該至少一待銲接處的溶液。
2. 根據申請專利範圍第 1 項所述的引流裝置，其中，該至少一引流槽包括一第一寬度及一第二寬度，該第一寬度小於該第二寬度。
3. 根據申請專利範圍第 2 項所述的引流裝置，其中，與該至少一穿孔連接之處的該至少一引流槽具有該第一寬度，與至少另一穿孔連接之處的該至少一引流槽具有該第二寬度。
4. 根據申請專利範圍第 1 項所述的引流裝置，其中，該待銲物為一印刷電路板。
5. 根據申請專利範圍第 1 項所述的引流裝置，其中，該至少一引流槽的形狀為長方形、正方形或其他幾何形狀。
6. 根據申請專利範圍第 1 項所述的引流裝置，其中，該至少一穿孔的形狀為長方形、正方形、多邊形或其他幾何形狀。
7. 根據申請專利範圍第 1 項所述的引流裝置，其中，該溶液為錫液、鉛液或其他的溶液。

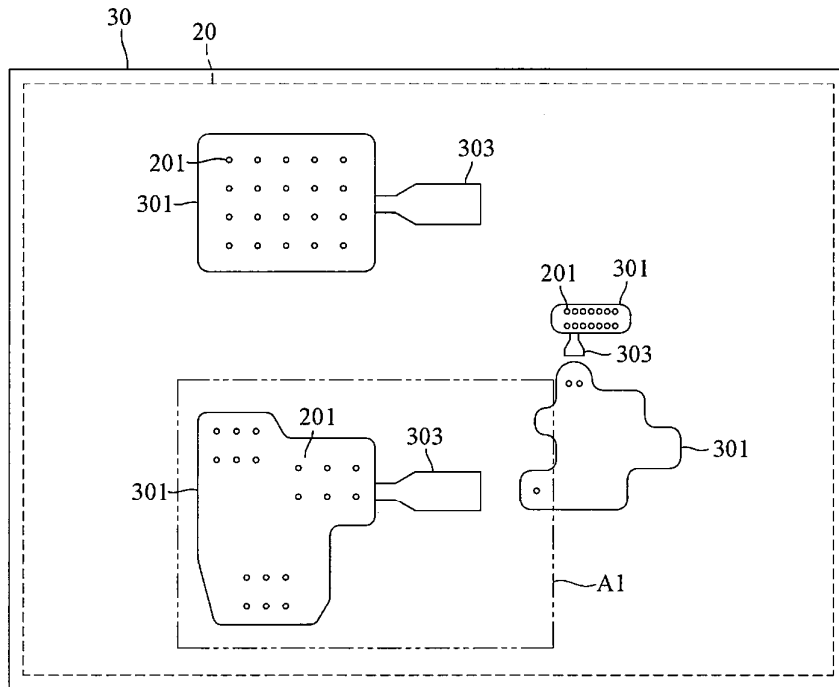
圖式簡單說明

本領域中具有通常知識者在參照附圖閱讀下方的詳細說明後，可以對本創作的各種態樣以及其具體的特徵與優點有更良好的了解，其中，該些附圖包括：圖 1 為說明習知技術中用於銲接的治具結構的俯視示意圖；圖 2 為說明本創作一實施例的改善銲接溶液量的引流裝置設置於待銲物上的結構的俯視示意圖；以及圖 3 為說明圖 2 中區域 A1 的放大示意圖。

(2)

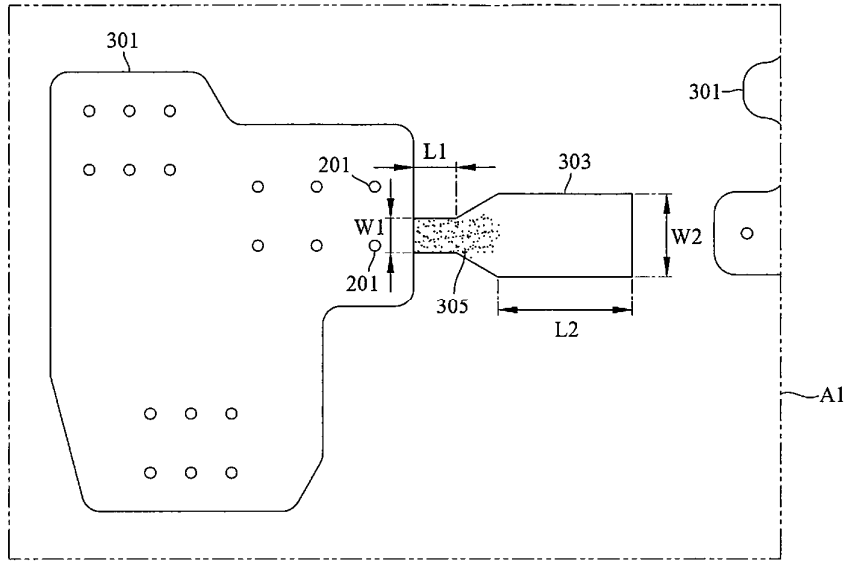


【圖1】



【圖2】

(3)



【圖3】